

附件 2-1

承办赛区/承办院校提供的设备和场地信息清单（模板）

承办赛区/承办院校 (盖章)		保山中等专业学校				
赛道	机械设计制造			组别 (中/高职)	中职	
类别	名称	型号	主要技术参数	台套数	设备厂商	备注
硬件	华中数控加工中心	VMC850	工作台: 工作台面尺寸: $\geq 900 \times 450\text{mm}$ 加工范围: $\geq 700 \times 400\text{mm}$ T型槽 (数目-尺寸*距离): 5-18 $\times 105\text{mm}$ 台面最大承重: $\geq 400\text{kg}$ 行程: X/Y/Z轴行程: $\geq 700/400/450\text{mm}$ 主轴鼻端至工作台面: $\geq 115-665\text{mm}$ 主轴: 主轴锥度: BT40 自动换刀系统: 标准配置容量: 24把 刀柄类型/锥度: MAS403 BT40 最大刀具直径: $\geq \Phi 80\text{mm}$ ($\Phi 135$ 邻空) 数控系统: HNC-818D	2	华中数控	
硬件	华中数控数控车床	CK40	床身形式: 平床身 床身上最大回转直径: $\Phi 420\text{mm}$ 导轨宽度: 350mm 通过中拖板最大回转直径: Φ 210mm 最大加工长度: 750mm 两顶尖距: 850mm X向 (横向) 最大行程: 250mm	2	华中数控	

			Z向（纵向）最大行程：850mm X向（横向）最快速度：8m/min Z向（纵向）最快速度：10m/min 主轴头部规格：A2-6 尾座顶尖锥孔：莫氏4#锥度 刀台形式：四工位立式电动刀台 刀柄规格：□25*25mm 数控系统：HNC-808D			
硬件	(直流焊机) 松下制造	YD400AT3H V	1、性能说明 1.1防护等级为IP23的高可靠性直流弧焊电源。 1.2 额定规格 1.3优秀的防尘防雨风道设计 1.4外壳防护等级达到IP23。风扇由后置前吹方式变为由上置下吹方式，降低粉尘和雨滴的侵入，延长了风扇使用寿命。 1.5优秀的三层四腔结构设计 主功率器件、P板、开关、电位器等内藏于2个密闭腔内，降低了粉尘侵入； 进风口位于顶层,有效地防止吹进粉尘；专门的散热通道大幅提高散热效率。 1.6耐高温设计 该机设计适应环境温度高达50℃，适应野外高温环境能力强。 1.7满足实际施工需求，功能丰富的精品机型！ 1.8 AT系列具备焊条电弧焊和简易TIG功能，还有适合纤维素焊条的专门机型。 1.9由多台电源可组成各种型号的电源组合，(头数可定制)适合于造船、石化等多种行业。 1.10推力电流任意调节，最大为220A。 1.11焊接过程中，出现粘条，应调节推力电流。 1.12由于不同焊条的电弧过渡形式不同，在熔滴短路瞬间将输出电流提高一个适当值，可明显提高焊接性能。	2	松下	

			1.13带有防触电功能，为在高空及潮湿环境下工作提供安全保障。 1.14延长电缆可达100米(300A, 60mm²)，可实现高空或远距离作业。 1.15适用于各种酸性、碱性、不锈钢、低氢焊条的焊接。 1.16 输入电压允许波动范围高达±20%。 2、技术参数 2.1控制方式：IGBT逆变方式 2.2额定输入电压 相数：AC380V 3相 2.3输入电源频率：50/60Hz 2.4额定输入容量：17.6KVA/16.7KW 2.5额定输出电流：400A 2.6额定输出电压：36V 2.7额定负载持续率：60% 2.8额定输出空载电压：71V 2.9输出电流范围：20-410A 2.10推力电流：最大220A 2.11引弧电流：最大150A 2.12外壳防护等级：IP23 2.13绝缘等级：200℃（主变130℃） 2.14冷却方式：强制风冷 2.15 TIG引弧方式：接触引弧 2.16外形尺寸(W×D×H)：327*560*602 (mm) 2.17重量：43kg			
硬件	桌面打印机	GS03	1.成型技术：熔融沉积成型（FDM）。 2.打印尺寸：≤360*360mm（X*Y）。 3.打印高度：≤350mm（Z）。 4.单机机身尺寸：≤495、宽515、高640mm。 5.组合机身尺寸：≤620、宽590、高910mm。 6.打印速度：≤600mm/s。 7.打印精度：100mm±0.1mm。 8.打印层厚：0.05-0.3mm。	2	创想	

			9挤出机类型：近端双齿轮挤出机。 10. 耗材直径：1.75mm。 11. 喷嘴直径：标配0.4mm; 0.2mm/0.6mm/0.8mm兼容。 12. 打印平台：柔性打印平台。 13. 调平方式：全自动调平。			
软件	数控加工软件	Mastercam 2026	支持广泛的CAD系统数据模型输入，软件应具备稳定可靠的通用数据接口，如：ASCII, CADL, DWG, DXF, EPS, IGES, Inventor (IPT, IDW, IAM), KeyCreator (CKD), Parasolids, Rhino3DM, SOLIDWORKS (SLDPRT, SLDASM, SLDDRW), SAT (ACIS Solids), Solid Edge (PAR & PSM), SpaceClaim (SCDOC), STEP, STL, VDA, CoroPlus	2	Mastercam2026 教育版	
技术支持	设备技术保障 赛前全面调试、精度校验与通电试运行，确保设备达标可用。技术人员全程驻场，故障快速响应，备有备件与备用机。实时巡检电压、温度、精度等关键参数，保障稳定运行。提供设备操作指导与应急处置支持。 本赛道针对3D打印、数铣数车、直流焊机各有1名技术支持。 安全操作规范要求持证操作，遵守规程，服从现场管理。数控设备检查夹具、刀具、防护装置，严禁超载超程。焊接作业做好防护，防火、防触电、防烫伤。3D 打印机禁止触碰高温运动部件，规范开关机。遇紧急情况立即停机断电，及时上报。保持场地整洁，通道畅通，严禁烟火。					
场地及环境	配220V 60HZ电源，2块移动大屏 每个赛场面积为6米*4米，面积内含数铣一台、数车一台、直流焊机一台、3D打印机一台、桌子两张、电源插板若干。 每支参赛队有1个工位用于封存摆放自带设备和产品，每个工位可适用面积约为1.5m² 提供一部台式机用于连接3D打印机进行切片操作，不可用于数车数铣编程 焊机仅提供直流焊机和绝缘地垫，若展示二保焊或氩弧焊请自带设备					

其他	现场有两块大屏，需参赛队用自带的笔记本电脑直接连大屏，并携带HDMI或DP线。 学校电子大屏参数： 屏幕尺寸：86 英寸 CPU ：1.Intel 酷睿 i5-2540 60GHz 2.Intel 酷睿 i5-6500 3.20GHz 3.Intel 酷睿i5-7400 3.00GHz 4.Intel 酷睿 i5-9400 2.90GHz 内存：1.4GB 2.8GB 硬盘：1.128GB SSD 2.256GB SSD 核显：1.Intel（R） HD Graphics 3000 2.Intel（R） HD Graphics 530 3.Intel（R） HD Graphics 630 系统：1.Windows 7 旗舰版 2.Windows 10 专业版 办公软件：WPS Office 12.1.0.25860 播放软件：QQ影音 v4.6.3.1104
----	--